



TLV9032QDGKRQ1

Număr parc	TLV9032QDGKRQ1	Statutul RoHs	
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	110446 pcs stock
Descriere produs	MEMORY	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

110446 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

2500 pcs

\$0.469

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLV9032QDGKRQ1

Tensiune - alimentare, Single / Dual (±)	1.65V ~ 5.5V	Tensiune - intrare (Max)	1.5mV @ 5V
Pachetul dispozitivului furnizor	8-VSSOP	Tip	General Purpose
Propunerea de întârziere (Max)	100ns (Typ)	Serie	Automotive, AEC-Q100
Pachet	Tape & Reel (TR)	Pachet / Caz	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C	Tipul de ieșire	Push-Pull, Rail-to-Rail
Tipul de montare	Surface Mount	Număr de elemente	2
Curent - Quiescent (Max)	30μA	Histerezis	-
Curent - intrare bias (Max)	5pA @ 5V	Curent - ieșire (tip)	100mA @ 5V
		CMRR, PSRR (tip)	70dB CMRR, 95dB

Vești înrudite



Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FutureGoogle Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13
Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/09/13

2023/08/31

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/21

2023/07/4

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

2023/08/30